

用途に合わせたラインアップ

紙フェノール基板 対応ペースト

SnAgCuペースト
EVASOL J3-8752-KF



紙フェノール基板で発生する泡をリフロー条件で押さえることは困難です。当社では発生メカニズムを解析することで泡が残らない溶ダペーストの開発に成功しました。



フラックス残渣泡立ち比較

J3-8752-KF

未対応品



大気リフロー対応 ICT用ペースト

SnAgCuペースト
EVASOL J3-8180-JE



大気リフローにおけるフラックス残渣の硬化をコントロールすることでN2不要の大気リフロー対応ICT用ペーストの開発に成功しました。

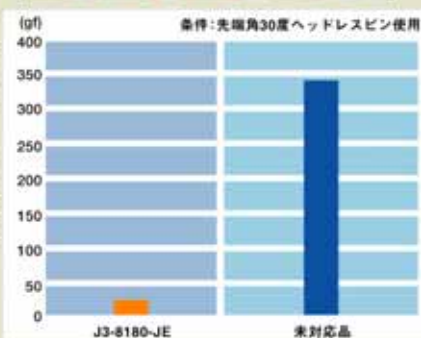


ぬれ性の確認



0.5mmピッチQFP

必要な
フラックス貫通に



水洗浄対応 ペースト

SnAgCuペースト
EVASOL J3-9001-KK



最適なフラックス材料を選定し、水洗浄可能な溶ダペーストの開発に成功しました。



水洗浄後写真

J3-9001-KK

未対応品



水洗浄性試験

